



协会活动:

2020 年度华强电子网优质供应商&电子元器件行业 优秀国产品牌评选活动进行中

为创造更为广阔行业企业同台竞技的平台，表彰优秀企业，树立行业标杆，为企业打造展示企业实力、提高企业知名度的平台，由华强电子网主办，江苏省半导体行业协会协办的第 13 届“年度优质供应商”评选活动已于 2020 年 12 月正式启动。

活动将通过“提名推荐、专家筛选、公众投票、专家评审”四个环节，评选出包括“2020 年度华强电子网优质供应商”、“2020 年度华强电子网最具诚信企业”、“2020 年度电子元器件行业优秀国产品牌”、“2020 年度华强电子网最佳人气企业”、“2020 年度华强电子网快递宝出货量 TOP10 企业”在内的五个奖项，其中，为进一步推动国产品牌走向市场，本次评选华强电子网联合各行业协会及商会等单位将“优秀国产品牌”一同纳入了评选范围。

经过 13 年的积累和沉淀，“华强电子网年度优质供应商”评选活动已成为一项具有广泛影响力的电子元器件行业盛事，在业界有着极佳的口碑及知名度。华强电子网本着公开、公正、公平的原则，以特有的方式记录着电子元器件行业杰出企业的成长历程。诚邀广大电子元器件行业企业参与我们的评选活动，共同见证优秀企业的发展历程。

报名截止时间：2021 年 1 月 12 日，附件下载地址：

<http://www.jssia.cn/ImageUp/file/2021/01/20210105001.zip> (010)

新闻动态：**科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》**

近日，科技部印发关于《长三角科技创新共同体建设发展规划》的通知。

文件提出，2025 年，形成现代化、国际化的科技创新共同体。长三角地区科技创新规划、政策的协同机制初步形成，制约创新要素自由流动的行政壁垒基本破除。涌现一批科技领军人才、创新型企业家和创业投资企业，培育形成一批具有国际影响力的高校、科研机构和创新型企业。

2035 年，全面建成全球领先的科技创新共同体。一体化的区域创新体系基本建成，集聚一批世界一流高校、科研机构和创新型企业。各类创新要素高效便捷流通，科技资源实现高水平开放共享，科技实力、经济实力大幅跃升，成为全球科技创新高地的引领者、国际创新网络的重要枢纽、世界科技强国和知识产权强国的战略支柱。

文件提出，共建一批长三角高水平创新基地。加强国家实验室、国家重点实验室、国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家临床医学研究中心等重大科技创新基地布局建设。鼓励沪苏浙皖三省一市在科技前沿、共性关键技术和公共安全等领域集中优势科技资源，创新体制机制，共建一批长三角实验室，支持网络通信与安全紫金山实验室、材料科学姑苏实验室加快发展。加快建设长三角国家技术创新中心，对标国际最高标准、最好水平，围绕提升重点产业领域技术创新水平，打通重大基础研究成果产业化的关键环节，构建风险共担、收益共享、多元主体的协同创新共同体，提升能够引领未来产业发展方向的技术创新策源能力。对标国际标准和通行规则，强化数据治理和标准建设，积极推动长三角科学数据中心建设。

文件还提出，共同打造重大科技基础设施集群。以上海张江、安徽合肥综合性国家科学中心为依托，加快构建世界一流的重大科技基础设施集群和区域重大科技基础设施网络，推动重大科技基础设施升级和联合建设，加快硬 X 射线自由电子激光装置、未来网络试验设施、超重力离心模拟与实验装置、高效低碳燃气轮机试验装置、聚变堆主机关键系统综合研究设施等重大科技基础设施建设，推进合肥先进计算中心建设，谋划筹建生物学大数据、系统生物学、纳米真空互联、作物表型组学、光子科学、新一代工业控制系统、智能计算等前沿领域的重大科技基础设施，为突破世界前沿重大科学问题、取得重大原创突破提供有力支撑。

政策解读:

国家税务总局发布集成电路所得税优惠常见问题解答

2020 年 12 月 31 日,国家税务总局纳税服务平台发布了“集成电路和软件产业企业所得税优惠政策常见问题解答”,对执行 2020 年第 45 号公告有关问题进行了解释。本刊梳理了相关重要内容,方便有关企业学习、掌握。

对于 45 号公告规定的优惠,不再全部转请核查,而是按是否采取清单管理区分为两种不同的管理方式:采取清单方式进行管理的,由国家发改委、工信部于每年 3 月底前按规定向财政部、税务总局提供上一年度可享受优惠的企业和项目清单;不采取清单管理方式的,税务机关仍按照财税〔2016〕49 号第十条的规定转请发改委、工信部门进行核查。同时就新老政策衔接问题进行了解释:在 45 号公告执行后,企业不符合新规定但符合原有政策条件且在 2019 年(含)之前已经进入优惠期的企业或项目,2020 年(含)起可按原有政策规定继续享受至期满为止;2019 年(含)之前尚未进入优惠期的企业或项目,2020 年(含)起不再执行原有政策。对于在 2019 年(含)之前已经进入优惠期的企业或项目,同时符合原有政策条件和 45 号公告政策条件的,可自行选择执行原有政策或 45 号公告政策。其中,选择执行 45 号公告政策的,就剩余期限享受优惠至期满为止。有关企业可至国家税务总局纳税服务平台查阅具体内容。(005)

数据统计:

2020 年 17 家半导体企业登陆科创板

2020 年,“科创板”以前所未有的速度和机制突破,为 A 股市场的未来发展带来深远影响。据不完全统计,2020 年有 17 家半导体企业陆续登陆科创板。

华峰测控,上市时间:2020 年 2 月 18 日;神工股份,上市时间:2020 年 2 月 21 日;华润微,上市时间:2020 年 2 月 27 日;沪硅产业,上市时间:2020 年 4 月 20 日;燕麦科技,上市时间:2020 年 6 月 8 日;中芯国际,上市时间:2020 年 7 月 16 日;寒武纪,上市时间:2020 年 7 月 20 日;芯朋微,上市时间:2020 年 7 月 22 日;力合微,上市时间:2020 年 7 月 22 日;高测股份,上市时间:2020 年 8 月 7 日;敏芯股份,上市时间:2020 年 8 月 10 日;仕佳光子,上市时间:2020 年 8 月 12 日;芯原股份,上市时间:2020 年 8 月 18 日;正帆科技,上市时间:2020 年 8 月 20 日;芯海科技,上市时间:2020 年 9 月 28 日;利扬芯片,上市时间:2020 年 11 月 11 日;恒玄科技,上市时间:2020 年 12 月 16 日。

除了上述已上市的半导体企业外,“科创板”的新锐正在有序走来。目前已受理的半导体企业 12 家,进入辅导期的有 20 多家。(003)

2020 半导体项目签约额超 5903 亿元 江苏一骑绝尘

2020 全年, 超 23 个省市落地半导体项目超 478 个, 仅统计披露投资额的项目, 全年落地项目总投资额超 5903 亿元。按投资排名介绍如下:

江苏, 2020 年超 112 个项目落地, 占全年落地总数 23.4%, 投资总额超 1239 亿元, 占全年投资总额的 21%。项目涵盖芯片设计、制造、封测等产业链, 涉及光刻机、第三代半导体、5G、传感器、触控、功率半导体、FPGA、材料等多个领域。3 个百亿元项目, 包括 150 亿元的无锡先导集成电路装备与材料产业园、百亿元的半导体蒸镀设备及硅晶圆生产项目、30 亿美元的梧升半导体 IDM 项目。

江西, 2020 年落地项目超 17 个, 占全年落地总数 4%, 投资总额超 909 亿元, 占全年投资总额的 15.4%。项目涵盖芯片研发、电子元器件生产、封装等, 涉及触控、第二代半导体、5G、第三代半导体等领域。两大百亿元产业园落地, 包括 260 亿元的中车产业园项目以及 300 亿元的康佳半导体产业园暨第三代化合物半导体项目。两大产业园投资总额占江西全年投资总额的 61.6%。

浙江, 2020 年落地项目超 38 个, 占全年落地总数 8%, 投资总额超 792 亿元, 占全年投资总额 13.4%。项目涵盖芯片设计、设备研发、芯片生产、先进封测、IDM 等, 涉及电子材料、触控、AI、5G、射频、通讯、传感器、激光、功率半导体、化合物半导体等领域。5 个百亿元项目, 127 亿元的甬矽电子(宁波)股份有限公司二期项目、106 亿元的嘉兴产城半导体产业园项目、100 亿元的创王光电 uNEED 总部基地项目、120 亿元的熙泰科技年产 25 万片硅基 OLED 微型显示器生产线项目、108 亿元的集成电路先进封测项目。

安徽, 2020 年落地项目超 30 个, 占全年落地总数 6.3%, 投资总额超 682 亿元, 占全年投资总额 11.6%。项目涵盖晶圆代工、晶圆制造、柔性触摸屏生产、封测、精密加工、MEMS 制造等, 涉及触控、存储、5G、第三代半导体、功率半导体、光刻胶、人工智能、材料等领域。3 个百亿元项目, 100 亿元的 TowerJazz 12 吋模拟集成电路项目、100 亿元的露笑科技第三代功率半导体(碳化硅)产业园、180 亿元的合肥晶合集成电路有限公司二期项目。

山东, 2020 年落地项目超 31 个, 占全年落地总数 6.5%, 投资总额超 625 亿元, 占全年投资总额 10.6%。项目涵盖研发生产、高端封测等, 涉及传感器、5G、触控、射频、人工智能等领域。2 个百亿元项目落地, 包括 111 亿元的中鸿新晶第三代半导体产业集群项目、160 亿元的柔宇科技柔性屏生产基地。

上海, 2020 年落地项目超 46 个, 占全年落地总数 9.6%, 投资总额超 618 亿元, 占全年投资总额 10.5%。项目涵盖芯片研发、晶圆制造、先进封测、存储器研制、设备制造, 涉及光芯片、AI、功率半导体、消费电子、第三代半导体、5G、射频、光刻机等领域。2 个百亿元项目, 22 亿美元的格科微电子 12 吋项目以及 120 亿元的 12 吋车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目。 (009)

信息速递：**★中欣晶圆 12 吋外延片正式下线**

2020 年 12 月 30 日，中欣晶圆 12 吋第一枚外延片正式下线，成为国内首家独立完成 12 吋单晶、抛光到外延研发、生产的企业。

杭州中欣晶圆自 2019 年 12 月底第一枚 12 吋抛光片下线至今，历时 12 个月的研发、生产，今天首枚 12 吋外延片顺利下线，不仅标志着中欣晶圆生产工艺技术的进一步提升，也标志着中欣晶圆为国内集成电路产业发展迎来了一个新的里程碑。

★上海新阳与北方集成电路技术创新中心（北京）签订《合作框架协议》

上海新阳公告，公司与北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司签署《合作框架协议》，双方将合作在北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司指定工厂搭建光刻胶验证平台，该平台由 ArF 光刻机和涂胶显影机组成，用于先进光刻胶验证；未来公司将采购的用于 193nm ArF 干法光刻胶研发的 ASML-1400 光刻机放置于合作方指定的地点，预计光刻机进入合作方现场的时间是 2021 年 3 月底前。

★临港新片区智芯源产业项目交付

12 月 28 日，位于上海自贸区临港新片区的上海地产闵虹(集团)有限公司下属“智芯源”产业项目集中签约并交付，签约企业项目总投资 65 亿元。其中，中晟光电设备（上海）股份有限公司、昕原半导体（上海）有限公司、新阳硅密（上海）半导体技术有限公司等 6 个集成电路产业项目正式签约“智芯源”。

★深创投等多家公司入股中芯集成电路制造绍兴集团有限公司

近日，中芯集成电路制造（绍兴）有限公司发生工商变更，公司新增多个股东，其中包括深圳市创新投资集团有限公司、厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州辰途华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）等。其注册资本，从 62 亿人民币增至 70.5 亿人民币。

中芯集成电路制造（绍兴）有限公司成立于 2018 年 3 月，由中芯国际和绍兴集成电路产业基金联合设立，一期总投资 58.8 亿元，从中芯国际转移并扩建一条 8 吋特殊工艺芯片生产线和模组封装生产线，提供微机电(MEMS)和功率器件(IGBT、MOSFET)芯片和模组生产服务。

★闻泰科技 12 吋车规级半导体晶圆制造中心项目正式开工

1 月 4 日，2021 年上海市重大项目开工仪式顺利举行。临港新片区 10 个投资额超 10 亿元的产业项目参加此次集中开工仪式，总投资超 300 亿元。其中，闻泰科技 12 吋车规级半导体晶圆制造中心项目正式开工。该项目由上海鼎泰匠芯科技有限公司投资，其控股股东闻天下投资有限公司为 A 股上市公司闻泰科技的控股股东。该项目总投资 120 亿元，预计年产品晶圆片 40 万片，经封装、测试后的功率器件产品，可广泛应用于汽车电子、计算和通信设备等领域，达产产值 33 亿元/年。

★2021 年半导体行业成长动力

2021 年基于多种增长动力，包括全球 GDP 增长的改善，5G 基站的强劲部署，5G 智能手机渗透率的提高以及汽车市场的持续复苏，半导体行业的预测基本保持乐观。摩根大通最新预测，行业的整体增长率为 8-10%，盈利增长为 15-18%。在未来的 18-20 个月中，半成品库存有望上涨 15-20%。

半导体设备预测：SEMI 数据，全球半导体制造设备市场预计在 2021 年达到 \$ 71.9B，高于 2020 年的 \$ 68.9B。晶圆代工厂预测：TrendForce 数据，全球晶圆代工厂收入在 2020 年结束时约为 \$ 84.6B，同比增长 24%，为近 10 年以来最高增长率。预计 2021 年，全球晶圆代工收入将增长 6%，再创新高。

★中国芯上市公司人均创收、人均创利榜出炉，大陆企业人均创利仅为国际巨头十分之一

集微网根据 120 家中国芯上市企业的公开财报信息，分析近 12 个月上市公司的人均创造营业收入和人均创造净利润，发布中国芯财富的人均创收排行榜以及人均创利排行榜。120 家中国芯 A 股上市公司人均创收为 145.92 万元，同比增加 17.40%；人均创利为 9.72 万元，同比增加 59.09%。由此可见，尽管 2020 年全球经济受到重创，但是中国半导体企业仍然保持着很高的增长率。数据显示，费城半导体成份股的全球 30 家半导体行业巨头人均创收为 59.81 万美元，约为 A 股公司的 2.8 倍；人均创利为 14.22 万美元，约为 A 股公司的 10 倍。由此可见，A 股公司的增长率虽然较高，但与全球顶尖公司相比仍有不少差距，尤其在人均创利方面差距非常大。

★中芯国际披露最新董事名单 梁孟松仍为联合首席执行官

2020 年 12 月 31 日，中芯国际发布最新的“董事名单和职能”公告，董事会成员包括董事长周子学、副董事长蒋尚义、联席 CEO 赵海军与梁孟松、首席财务官高永岗等。

★ 立昂微拟设立子公司实施微波射频集成电路芯片项目

立昂微发布公告，公司与浙江省海宁市人民政府、浙江省海宁经济开发区管理委员会于 2020 年 12 月 24 日在浙江省海宁市签订《关于微波射频集成电路芯片项目投资协议书》，投资项目名称为“微波射频集成电路芯片项目”。为此，公司拟在浙江省海宁经济开发区注册设立海宁立昂东芯微电子有限公司，注册资本为 50000 万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

★ 杭州集成电路测试公共服务中心在滨江启用

近日，杭州集成电路测试公共服务中心在高新区（滨江）正式启用。该中心由杭州国家“芯火”双创基地（平台）、杭州朗迅科技集团有限公司共同建设，坐落于杭州高新区（滨江）海外高层次人才创新创业基地。

测试公共服务中心定位：专业从事半导体加工工序，瞄准中高端芯片测试，提供专业测试服务，形成较为完整的集成电路产业生态体系。

测试公共服务中心目标：搭建良好的半导体产业发展生态，完善集成电路产业链，致力于提升浙江省及长三角地区集成电路产业的综合实力，打造集成电路产业集聚区。

★ 合肥强友科技 IC 托盘生产制造项目奠基仪式举行

近日，合肥强友科技有限公司 IC 托盘生产制造项目奠基仪式在合肥经济技术开发区举行。项目总投资约 3 亿元，主要从事 IC 托盘生产及 LCD 包装托盘及特殊复合材料精密射出成型 Cassette 并提供半导体应用材料及制程耗材等。

★ 南京浦口经济开发区为加速集成电路产业发展“用芯办”

在南京市全力打造集成电路产业地标跨入第三个年头之际，浦口经济开发区“用芯办”智慧园区 APP 赶在新旧交替的临界点正式上线。“用芯办”APP 是浦口经济开发区定制的手机客户端，旨在为园区管理、企业发展、商户合作、员工生活打造一款便捷的掌上互动服务平台，具有园区管理、企业服务、政务服务、产业服务、生活服务五大服务模块。“用芯办”APP 包括工商代办、财税服务、法律服务、办公服务、咨询服务、技术研发、成果转化、专利代理、活动组织、人力资源、人才政策申报、人才培养、员工住宿、购物消费等多项服务，通过系统化的服务体系将浦口经济开发区各载体平台、职能机构、各类配套构筑成一体化的创新经济生态圈，是集创新创业、科技研发、生活休闲于一体的全功能载体。为帮助入驻企业成长以及项目发展所需的资金扶持，都可以通过“用芯办”APP 线上提交资料，线上申请获得扶持资金。 (002)

★应用材料再提收购国际电气

美国半导体设备大厂应用材料 1 月 4 日表示, 基于当前半导体设备产业良好前景, 针对收购日本半导体设备同业国际电气(Kokusai Electric)公司, 将支付 35 亿美元作为最终购并国际电气的收购金额, 比 2019 年 7 月宣布的 23 亿美元收购金额, 高出约 59%。

应用材料曾在 2013 年提出收购同样是半导体设备供应商的日本东京威力科创(Tokyo Electron Ltd.) 计划。但是那一次的收购引发了市场垄断的疑虑, 最终撤销收购计划。有了之前的例子, 预计应用材料这次也将会受到各国反垄断审查单位的关注。

同业国际电气拥有用于薄膜沉积设备的技术, 这是一种在硅芯片上添加薄膜以形成电路的技术, 这也是应用材料希望能购并同业国际电气的原因。(002)

★集邦咨询 2020 年全球晶圆代工产值将达 846 亿美元同比增长 23.7%

市调机构集邦咨询的最新预测, 2020 年全球晶圆代工产值将达 846 亿美元, 同比增长 23.7%, 成长幅度创近十年记录。预估 2021 年晶圆代工产值可望再创新高, 年成长近 6%。

★韩媒三星 SK 海力士 2021 年将对 DRAM 保守投资

据韩国媒体《MoneyToday》消息, 三星计划将 2021 年 DRAM 资本支出维持在 2020 年水平, 但会将某些 DRAM 产线转换为图像传感器产线。亦即, 2021 年三星将事实上减少 DRAM 资本支出。

与此同时, SK 海力士对 DRAM 的投资也保持保守, 并增加晶圆代工和 NAND 方面的资本支出。

★70 亿元高端元器件制造项目签约落户嘉兴

近日, 浙江嘉兴科技城举行了集中签约仪式, 仪式上, 半导体光电集成芯片项目和高端元器件制造项目等 8 个项目签约落户, 总投资 88.8 亿元, 涵盖集成电路、生物医药等领域。签约的部分项目: 高端元器件制造项目总投资 70 亿元, 将建成高端元器件制造基地, 预计可实现年销售收入 25 亿元。半导体光电子集成芯片项目注册资金 1000 万元, 由国家级领军人才领衔, 主要从事新型可调谐激光器芯片及模块、芯片光谱仪的研发和产业化, 预计可实现营收 2000 万元, 税收 100 万元。

声明:

- 1、本刊中若有不当或错误之处, 诚望各位领导、业界专家和同仁批评指正, 并致以谢意。
- 2、未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本刊之部分或全部内容。